

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

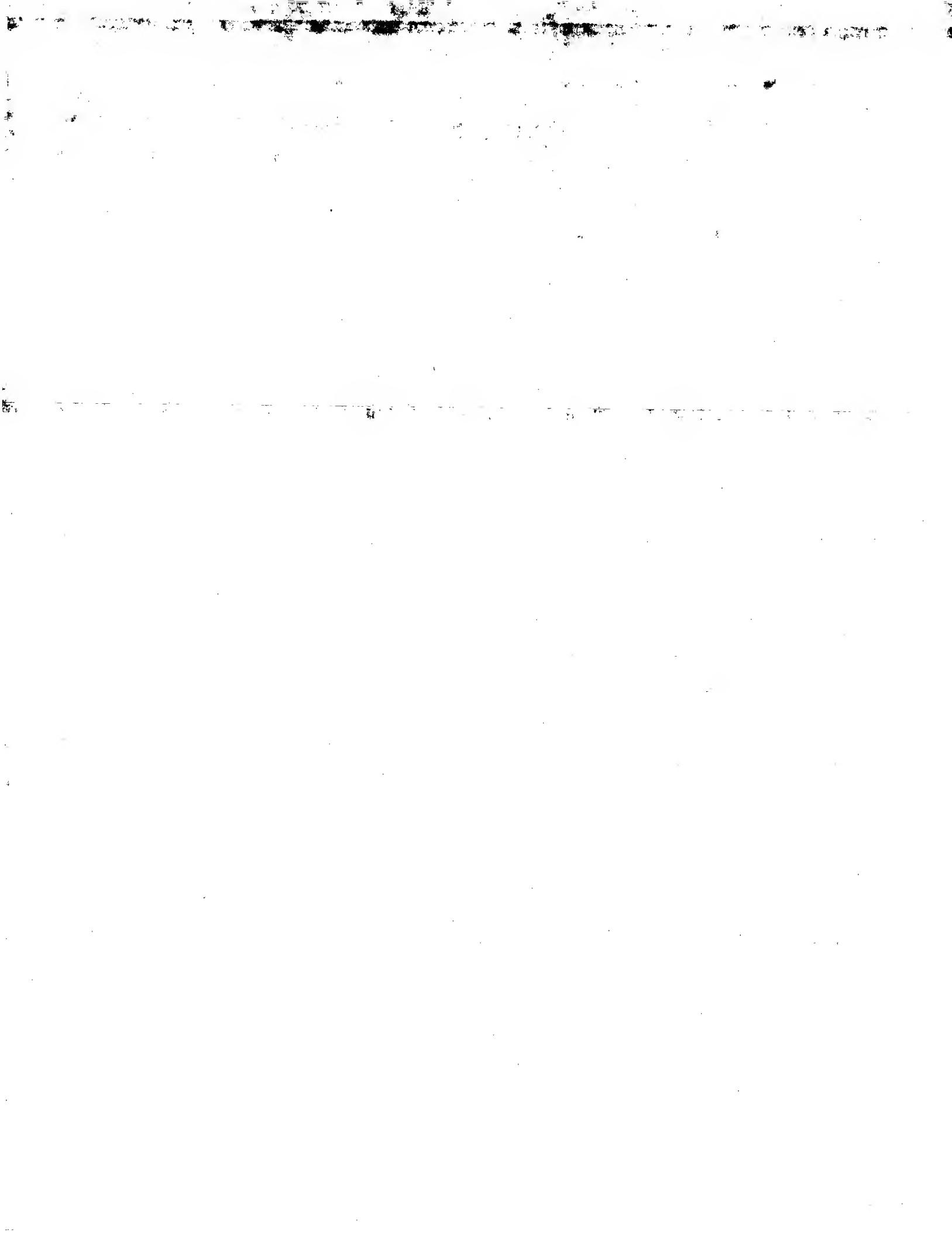
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-039665
(43)Date of publication of application : 10.02.1992

(51)Int.Cl.

G03F 7/038
H01L 21/027

(21)Application number : 02-146803
(22)Date of filing : 05.06.1990

(71)Applicant : FUJITSU LTD
(72)Inventor : TAKECHI SATOSHI

(54) RADIATION SENSITIVE MATERIAL AND PATTERN FORMING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a submicron pattern to be formed in high precision by using a polymer or copolymer of an acrylate or α-substituted acrylate having an adamantane structure in the ester part for a photosensitive material.

CONSTITUTION: The resist pattern is formed by using the radiation sensitive material made of the polymer or copolymer of the acrylate or the α-substituted acrylate having the adamantane structure in the ester part, coating the substrate to be processed, with the obtained resist, and selectively exposing the substrate to radiation, and then developing it, thus permitting the obtained photosensitive material to be enhanced in transparency to the ionizing radiation, to form a resist pattern sufficient in etching resistance, and consequently, to obtain a submicron pattern high in precision.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

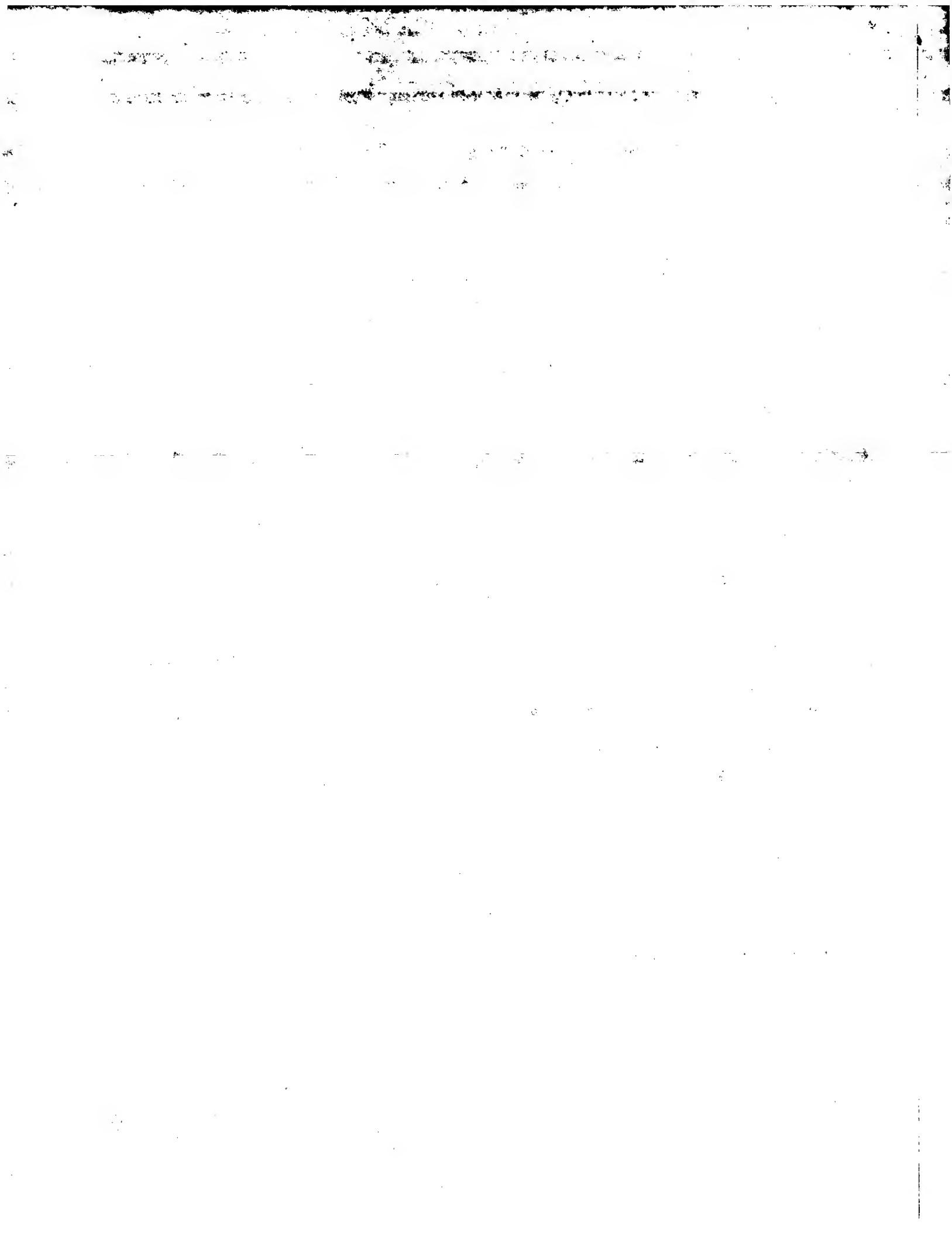
[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



⑫ 公開特許公報 (A)

平4-39665

⑤Int.Cl.⁵
G 03 F 7/038
H 01 L 21/027識別記号
501庁内整理番号
7124-2H

④公開 平成4年(1992)2月10日

7352-4M H 01 L 21/30 301 R
審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

⑥発明の名称 放射線感光材料とパターン形成方法

⑦特 願 平2-146803

⑧出 願 平2(1990)6月5日

⑨発明者 武智敏 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

⑩出願人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

⑪代理人 弁理士 井桁貞一

明細書

1. 発明の名称

放射線感光材料とパターン形成方法

に遠紫外光に対して透明性に優れたレジストを実用化することを目的とし、

2. 特許請求の範囲

(1) エステル部にアダマンタン骨格を有するアクリル酸エステルまたは α 置換アクリル酸エステルの重合体か、或いは該エステルの共重合体からなることを特徴とする放射線感光材料。エステル部にアダマンタン骨格を有するアクリル酸エステルまたは α 置換アクリル酸エステルの重合体か、或いは該エステルの共重合体からなる放射線感光材料を用いてレジストを形成し、該レジストを塗布した被処理基板に放射線を選択露光した後に現像し、レジストパターンを形成することを特徴としてパターン形成方法を構成する。

(2) 請求項1記載の放射線感光材料を用いてレジストを形成し、該レジストを塗布した被処理基板に放射線を選択露光した後に現像し、レジストパターンを形成することを特徴とするパターン形成方法。

〔産業上の利用分野〕

本発明は放射線感光材料とパターン形成方法に関する。

3. 発明の詳細な説明

〔概要〕

放射線用レジストに関し、

優れたエッティング耐性を示すと共に放射線、特

半導体集積回路は集積化が進んでLSIやVLSIが実用化されており、これと共に配線パターンの最小線幅はサブミクロン(Sub-micron)に及んでいるが更に微細化の傾向にある。

ここで、微細パターンの形成には薄膜を形成した被処理基板上にレジストを被覆し、選択露光を行った後に現像してレジストパターンを作り、こ

特開平4-39665 (2)

れをマスクとしてドライエッティングを行い、その後にレジストを溶解除去することにより薄膜パターンを得る写真蝕刻技術の使用が必須である。

この写真蝕刻技術に使用する光源として、当初は紫外線が使用されていたが、波長による制限からサブミクロン幅の解像は不可能であり、これに代わって波長の短い遠紫外線や電子線、X線などを光源としてサブミクロン幅の解像が行われるようになった。

本発明はこれら放射線用レジスト材料に関するものである。

〔従来の技術〕

レジストとして従来はフェノール樹脂をベースとするものが数多く開発されてきた。

然し、これらの材料は芳香族環を含むために光の吸収が大きく、そのため微細化に対応できるだけのパターン精度は得られない。

一方、吸収の少ない樹脂としてポリメチルメタクリレート(略称PMMA)やポリメチルイソプロピ

放射線を選択露光した後に現像し、レジストパターンを形成することを特徴としてパターン形成方法を構成することにより解決することができる。

〔作用〕

本発明は遠紫外光に対して透明性が優れ、且つ、充分なエッティング耐性をもつ感光材料として、アダマンタン骨格を有するアクリル酸エステルまたは α 置換アクリル酸エステルの重合体か、或いはこのエステルの共重合体からなる材料を用いるものである。

すなわち、第1図の(1)式で構造を示すアダマンタン($C_{10}H_{16}$)は椅子型構造のシクロヘキサン環を構成単位としており化学的に非常に安定な化合物として知られ、医薬品への用途開発が試みられている。

発明者はアダマンタン骨格を分子中に含むポリマーは芳香族環がないにも拘らず優れたエッティング耐性を示し、また遠紫外光に対して吸収が少ない点に着目した。

ルケトン(略称PMIPK)などが検討されているが、芳香族環を含んでいないために充分なエッティング耐性をもっていない。

これらのことから、透明性に優れ、且つ充分なエッティング耐性を備えたレジストは実用化されていない。

〔発明が解決しようとする課題〕

以上記したようにサブミクロンの微細パターンを現像するには遠紫外光に対して透明性が優れ、且つ、充分なエッティング耐性をもつ感光材料が必要であり、この両方の特性を兼ね備えた放射用感光材料を実用化することが課題である。

〔課題を解決するための手段〕

上記の課題はエステル部にアダマンタン骨格を有するアクリル酸エステルまたは α 置換アクリル酸エステルの重合体か、或いはこのエステルの共重合体からなる放射線感光材料を用いてレジストを形成し、このレジストを塗布した被処理基板に

そこで、この特徴を活かし、エステル部にアダマンタン骨格を有するアクリル酸エステルまたは α 置換アクリル酸エステルの重合体か、或いはこのエステルの共重合体を感光材料として使用するものである。

このような感光材料は優れたエッティング耐性をもつと共に透明性に優れているため、精度よくサブミクロンパターンを形成することができる。

〔実施例〕

実施例1：

第1図の(2)式に構造式を示すアダマンチルメタクリレート4.4 gとベンゼン5.0 gに反応開始剤としてアゾイソブルロニトリル(略称AIBN)0.5モル%を加え、70°Cで約8時間重合した後、メタノールで再沈精製を行った結果、重量平均分子量18万、分散度1.6のポリマーが得られた。

これをキシレン溶液とした後、石英基板上に1.0 μm 厚に被覆し、遠紫外光(248nm)に対する透明性を調べた結果、透過率は97%であって、PMMA

と同等であった。

なお、PMMAの透過率は98%またフェノールノボラック樹脂の透過率は30%である。

更に、四弗化炭素ガス(CF₄)によるエッティングレートをPMMAと比較した結果、PMMAのエッティングレートが1330Å／分であるのに対しポリアダマンチルメタクリレートは860 Å／分と優れていた。

なお、エッティング条件は、CF₄の流量は20sccm、真空中度は 1×10^{-3} torr、μ波の出力は1 KW、高周波電力は100 Wである。

次に、得られたアダマンチルメタクリレートポリマーに架橋剤として第1図の(3)式に構造式を示す4,4'-ジアジドジフェニルメチレンを20重量%添加してキシレン溶液とし、Si基板上に0.5 μmの厚さに塗布した後、100 °Cで30分間ブリベークした。

その後、キセノン・水銀(Xe-Hg)ランプにより30秒間露光した後、キシレンで60秒間現像してパターンニング特性を調べた。

その結果、0.6 μmのライン・アンド・スペー

スパターンを解像することができた。

比較例1：

フェノールノボラック樹脂をベースにしたg線(436nm)用レジストを用い、実施例1と同様な実験を行ったが、得られたレジストパターンの断面形状はテーパー状となつた。

実施例2：

実施例1のアダマンチルメタクリレートの代わりに第1図の(4)式に構造式を示すジメチルアダマンタンアクリレートを用いて同様な実験を行った結果、同様な結果を得られた。

実施例3：

実施例1において架橋剤として4,4'-ジアジドフェニルメチレンの代わりに第1図の(5)式に構造式を示す4,4'-ジアジドフェニルスルホンを用いても同様な結果を得ることができた。

実施例4：

AIBNを重合開始剤とし、アダマンチルメタクリレートとメタクリル酸とを1,4-ジオキサン中で80 °C、8時間重合させた後、ヘキサンを用いて再沈

精製を行った結果、重量平均分子量2万、分散度2.0、組成比が7:3の共重合体が得られた。

このポリマーに架橋剤として4,4'-ジアジドフェニルメチレンを30重量%加えてシクロヘキサン溶液とし、Si基板上に0.5 μmの厚さに塗布した後、100 °C、30分間ブリベークを行った。

その後、Xe-Hgランプにより30秒間露光したのち、アルカリ現像を行った。

その結果、0.5 μmのライン・アンド・スペースパターンを解像することができた。

なお、エッティング耐性はポリアダマンチルメタクリレートの場合と同様であった。

実施例5：

実施例4と同様な方法によりアダマンチルメタクリレートとメタクリル酸t-オブチルを共重合した結果、重量平均分子量1.2万、分散度1.5、組成比が6:4の共重合体が得られた。

このポリマーに酸発生剤であり、第1図の(6)式に構造式を示すトリフェニルスルホニウムヘキサフロロホスフェートを5重量%加えてシクロヘキ

サン溶液とし、Si基板上に1.0 μmの厚さに塗布した後、90 °C、30分間ブリベークを行った。

その後、Xe-Hgランプにより5秒間露光したのち、110 °Cで20分のペークを行った後、アルカリ現像を行った。

その結果、0.5 μmのライン・アンド・スペースパターンを解像することができた。

なお、エッティング耐性はポリアダマンチルメタクリレートの場合と同様であり、また樹脂の透明性はPMMAと同様であった。

実施例6：

実施例5において、酸発生剤として第1図の(7)式に構造式を示すジフェニルアイオードヘキサフロロホスフェートを用いても同様な結果が得られた。

実施例7：

実施例4においてアダマンチルメタクリレートの代わりにアダマンチルアクリレートを用いた場合も同様な結果を得ることができた。

実施例8：

実施例1と同様の溶液重合により、重量平均分子量1.2万、分散度1.5、組成比が6:4の共重合体が得られた。

この重合体に第1図の(8)式に構造式を示す4-4
-ジアドカルコンを7重量%添加してキシレン
溶液とした。

この溶液をSi基板上に $1.0 \mu\text{m}$ の厚さに塗布した後、N₂気流中で200 °C、1時間のプリベークを行い、熱架橋させて不溶化した後、加速電圧20kVの電子線露光装置で露光した。

この後、キシレンで現像した結果、 $64 \mu C/cm^2$ の露光量で $0.8 \mu m$ のライン・アンド・スペースパターンを解像することができた。

なお、同様な実験をPMMAを用いて行い、エッチング耐性を比較した結果、PMMAの1.5倍であった。
実施例9：

実施例5において現像液としてアルカリ現像液の代わりにキシレンを用いることにより、 0.8μ のライン・アンド・スペースのネガパターンを得ることができた。

(発明の効果)

本発明によれば、電離放射線に対し、透明性が高く、且つ充分なエッティング耐性をもつレジストパターンを得ることができ、これによりサブミクロン・パターンを得ることができる。

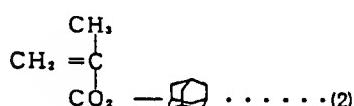
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施において使用した有機化合物の構造式である。

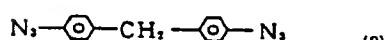
代理人 井理士 井折 直



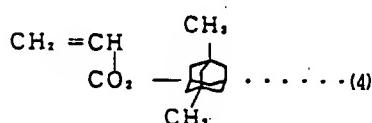
アダマンタンの構造式



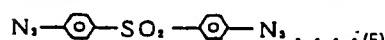
アダマンチルメタクリレートの構造式



4. A^+ = ジアジドフルオルメチレンの構造式



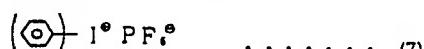
ジメチルアダマンタンアクリレートの構造式



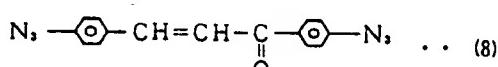
4. 4° -ジアジドジブチルスルホンの構造式



トリフェニルスルホニウムヘキサフロロホスフートの構造式



ジフェニルアイオニアドへキサフルオロキスフートの構造



4. 4' -ジアジドカルコンの構造式

本発明の実施において使用した有機化合物の構造式

第一圖 (その2)